

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年3月10日 (10.03.2005)

PCT

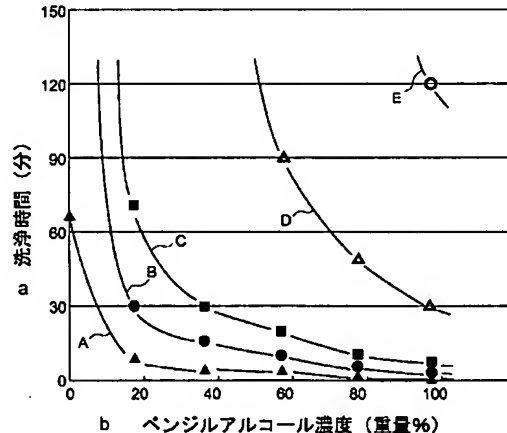
(10) 国際公開番号  
WO 2005/021700 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C11D 7/26, 7/32, 7/60, H05K 3/26 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/011455 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 堀 薫夫 (HORI, Shigeo) [JP/JP]; 〒5760031 大阪府交野市森南3丁目39番6号 化研テック株式会社内 Osaka (JP). 高橋久和 (TAKAHASHI, Hisakazu) [JP/JP]; 〒5270065 滋賀県八日市市下二俣町901 化研テック株式会社 滋賀工場内 Shiga (JP). 古井 裕彦 (FURUI, Hirohiko) [JP/JP]; 〒5270065 滋賀県八日市市下二俣町901 化研テック株式会社 滋賀工場内 Shiga (JP). 中司 宏樹 (NAKATSUKASA, Hiroki) [JP/JP]; 〒5270065 滋賀県八日市市下二俣町901 化研テック株式会社 滋賀工場内 Shiga (JP).  
(22) 国際出願日: 2004年8月10日 (10.08.2004)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ: 特願2003-302870 2003年8月27日 (27.08.2003) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 化研テック株式会社 (KAKEN TECH CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5760031 大阪府交野市森南3丁目39番6号 Osaka (JP). (74) 代理人: 江森 健二, 外 (EMORI, Kenji et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿1-1 1-3 エクセル新宿御苑ビル5F Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: CLEANING AGENT FOR REMOVING SOLDER FLUX AND METHOD FOR CLEANING SOLDER FLUX

(54) 発明の名称: 半田フラックス除去用洗浄剤および半田フラックスの洗浄方法



a...CLEANING TIME (MINUTE)

b...BENZYL ALCOHOL CONCENTRATION (WEIGHT%)

(57) Abstract: Disclosed is a cleaning agent exhibiting excellent cleaning performance even in cleaning of a flux for lead-free solders or a flux for high-melting-point solders and further exhibiting excellent rinsing characteristics in the following rinsing step wherein an alcohol solvent is used. Also disclosed is a method for cleaning a solder flux. A cleaning agent for removing a solder flux is constituted such that the content of a benzyl alcohol is within 70-99.9 weight% and the content of an amino alcohol is within 0.1-30 weight% in case when the content of a glycol compound is less than 1 weight% relative to the total amount, while the content of the benzyl alcohol is within 15-99 weight% and the content of the amino alcohol is within 0.1-30 weight% in case when the content of the glycol compound is 1-40 weight%. Such a cleaning agent is used for cleaning a flux for lead-free solders or a flux for high-melting-point solders.

(57) 要約: 鉛フリー半田用フラックスや高融点半田用フラックス等を洗浄する際であっても、優れた洗浄性を示すとともに、次工程におけるアルコール系溶剤を使用したリンスにおいても優れたリンス特性を示すことができる半田フラックス除去用洗浄剤および半田フラックスの洗浄方法を提供する。そのため、全体量に対して、グリ

[続葉有]



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

コール化合物の含有量が1重量%未満の場合には、ベンジルアルコールの含有量を70～99.9重量%の範囲およびアミノアルコールの含有量を0.1～30重量%の範囲とし、グリコール化合物の含有量が1～40重量%の場合には、ベンジルアルコールの含有量を15～99重量%の範囲およびアミノアルコールの含有量を0.1～30重量%の範囲とした半田フラックス除去用洗浄剤を構成し、それを鉛フリー半田用フラックスや高融点半田用フラックス等の洗浄に使用する。